



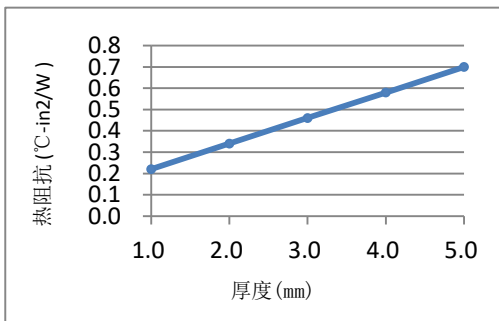
特性

- 》良好的热传导率：**5.0 W/mK**
- 》双组份材料，易于储存
- 》优异的高低温度机械性能及化学稳定性
- 》适用于低压力环境
- 》可依温度调整固化时间
- 》可用自动化设备调整厚度

应用

- 》计算器硬设备
- 》通信设备
- 》汽车用电子设备
- 》导热减震设备
- 》散热片及半导体

热阻抗

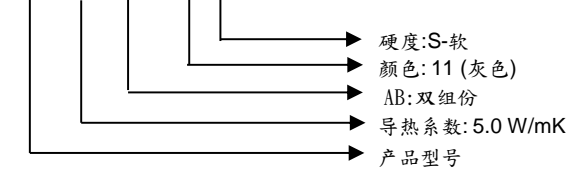


TIF™ 050AB-11S是一种高热导、液态间隙填充材料，具有双组份及不同温度固化时间特点。它们的柔性、弹性特征使其能够用于覆盖非常不平整的表面。热量从分离器件或整个PCB传导到金属外壳或扩散板上，因而能提高发热电子组件的效率和使用寿命。以液态方式，提供各种厚度，取代一般导热垫片的模切厚度，且不同于一般硅胶片，此系列产品固化后是干燥可触摸的，故可被更广泛应用。

TIF™050AB-11S系列特性表		
未固化材料特性		
性质	数值	测试方法
颜色 (A组份)	白色	目视
颜色 (B组份)	灰色	目视
混合粘度	1500,000cPs	GB/T 10247
密度	3.0 g/cc	ASTM D792
混合比例	1:1	*****
保质期25℃	6个月	*****
固化条件		
操作时间25℃ (分钟)	30 分钟	*****
固化时间25℃ (分钟)	60 分钟	*****
固化时间100℃ (分钟)	30 分钟	*****
固化后材料性能		
颜色	灰色	目视
硬度	45 Shore 00	ASTM D2240
工作温度	-45 ~ 200℃	*****
耐电压强度	200 V/mil	ASTM D149
介电常数	4.1 MHz	ASTM D150
体积电阻率	10 ¹² Ohm-meter	ASTM D257
阻燃等级	94 V0	E331100
导热系数	5.0 W/mk	ISO22007-2
比热容	2.3 MJ/m³K	ISO22007-2

产品型号说明

TIF 050 AB - 11 S



导热介面材料
应用技术下载



<http://www.ziitek.com>

产品规格

50 cc/支, 48 支/箱; 400 cc/支, 9 支/箱
或在注射器用于自动化应用定制包装。

如欲了解不同规格产品信息请与本公司联系。

<p>导热材料</p> <p>加拿大: Tel: +001-604-2998559 E-mail: sales@thermazig.com</p>	<p>导热工程塑料</p>	<p>发热材料</p>	<p>屏蔽材料</p>	<p>发泡硅胶</p>	<p>模切制品</p> <p>台湾: Tel: +886-2-22771007 E-mail: frances@ziitek.com.tw</p>
--	----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--

以上资料与说明相信是可靠的,但不作为法律的解释或保证,用户须进行充分的测试与确认上述讯息适合用户所提出任何特殊的产品与应用。